

東北大学マイクロシステム融合研究開発センター 試作コインランドリ 装置担当リスト (2024年10月~)

Tel. 022-229-4113

分類	番号	装置名称	Equipment name	メーカー型番	☆: 主担当 ○: オート対応可能											
					戸津	森山	渡邊	菊田	辺見	庄子	吉田	松本	鶴谷	八重樫	吉林	村上
洗浄・乾燥	A-01	エッチングチャンバー	Draft chamber	アズワン PSH1200	○	○	○	○	○	○	☆	☆	○	○	○	○
	A-02	有機ドラフトチャンバー	Draft Chamber for organic		○	○	○	○	○	☆	☆	○	☆	○	○	○
	A-03	リン酸槽	Draft chamber for SIN etching							☆	☆	○	○			
	A-04	スピンドライヤー	Spin dryer	東邦化成 ZAA-4	○	○	○	○	☆	○	☆	○	○	○	○	○
	A-05	4"スピンドライヤー	4" Spin dryer	SEMITOOL PSC101							☆	○				
	A-06	6"スピンドライヤー	6" Spin dryer	SEMITOOL PSC101							☆	○				
	A-07	シンター用オーブン	Inert oven for sintering	ヤマト科学 DN63H							☆	○				
	A-08	真空オーブン	Vacuum oven	ヤマト科学 DP-31	○	○	○	○	○	☆	☆			○	○	
	A-09	ブラシスクラバ	Brush scrubber	全協化成		○		○								☆
リソグラフィ	B-01	ミカサ スピコータ	Mikasa spin coater	ミカサ 1H-DXII	○	○	○	○	☆	○	☆	○	○	○	○	○
	B-02	アクテス スピコータ#1	Actes spin coater #1	アクテス ASC-4000	○	○	○	○	☆	○	☆	○	○	○	○	○
	B-03	アクテス スピコータ#2	Actes spin coater #2	アクテス ASC-4000w	○	○	○	○	☆	○	☆	○	○	○	○	○
	B-04	ホットプレート	Hot plate	Shamal HHP-2305SQ	○	○	○	○	☆	○	☆	○	○	○	○	○
	B-05	クリーンオーブン	Clean oven	ヤマト科学 DE62	○	○	○	○	☆	○	☆	○	○	○	○	○
	B-06	両面アライナ #1	Double-side aligner #1	Suss MA6/BA6	○	○			○	☆	○	☆	○	○	○	○
	B-07	両面アライナ #2	Double-side aligner #2	Suss MA6/BA6	○	○			○	☆	○	☆	○	○	○	○
	B-08	レーザー描画装置	Laser writer	Heidelberg Instruments DWL2000CE	○	○					○	☆		○	○	○
	B-09	マスクレスアライナ	Maskless aligner	Heidelberg Instruments MLA150							☆			○	○	○
	B-10	スプレー現像装置	Spray developer	アクテス ADE-3000S		○				☆					○	
	B-11	現像ドラフト	Draft chamber for development		○	○	○	○	○	☆	☆	○	○	○	○	○
	B-12	スピンドライヤー	Spin dryer	東邦化成 ZAA-4	○	○	○	○	☆	○	☆	○	○	○	○	○
	B-13	コートデベロッパ	Coater developer	Suss ACS200Gen3							☆		○			
	B-14	i線ステッパ	i-line stepper	キヤノン FPA-3030i5+						☆				☆		
	B-15	エリオニクス 130kV EB描画装置	Elionix 130kV EB lithography	エリオニクス ELS-G125S						☆				○		
	B-16	エリオニクス 50kV EB描画装置	Elionix 50kV EB lithography	エリオニクス ELS-7500X						☆				○		
	B-17	ポリイミドキュア炉	Curing oven	ヤマト科学 DN43H				○	○	☆	○					
	B-18	UV キュア装置	UV curing	ウシオ電機 UMA-802							☆					
	B-19	球面露光装置	Maskless exposure system for ball	東栄科学産業		☆										
	B-20	両面アライナ #3	Double-side aligner #3	SUSS MA8/BA8 Gen3							☆					
	B-21	BEAMER PC									○					☆
酸化拡散・イオン注入・熱処理	C-01	酸化炉 (半導体用)	Oxidation (semiconductor)	東京エレクトロン XL-7							☆	○				
	C-02	酸化炉 (MEMS用)	Oxidation (MEMS)	東京エレクトロン XL-7							☆	○				
	C-03	酸化炉 (8")	Oxidation (8")	光洋サーモシステム							☆	○				
	C-04	拡散炉 (P拡散炉)	P diffusion	東京エレクトロン XL-7							☆	○				
	C-05	拡散炉 (P押し込み炉)	P drive-in	東京エレクトロン XL-7							☆	○				
	C-06	拡散炉 (B拡散炉)	B diffusion	東京エレクトロン XL-7							☆	○				
	C-07	拡散炉 (B押し込み炉)	B drive-in	東京エレクトロン XL-7							☆	○				
	C-08	メタル拡散炉	Metal diffusion furnace	光洋リンドバーグ Model270					☆							
	C-09	中電流イオン注入装置	Middle-current ion implanter	日新イオン機器 NH-20SR							☆	☆				
	C-10	アニール炉	Annealing	東京エレクトロン XL-7							☆	○				
	C-11	ランブアニール装置	Rapid thermal annealing	AG Associates AG4100							☆	☆				
	C-12	水素アニール炉	Hydrogen annealing	金森義明教授オリジナル					☆							
	C-13	真空アニール炉	Vacuum annealing	真空理工 RHL-Pss98/98#					☆							
成膜	D-01	LPCVD (SiN)	LPCVD (SiN)	システムサービス							☆	○				
	D-02	LPCVD (Poly-Si)	LPCVD (Poly-Si)	システムサービス							☆	○				
	D-03	LPCVD (SiO2, SiON)	LPCVD (SiO2, SiON)	システムサービス							☆	○				
	D-04	熱CVD	Thermal CVD	国際電気			☆									
	D-05	住友精密PECVD	Sumitomo PECVD	住友精密 MPX-CVD	○		☆					○				
	D-06	住友精密TEOS PECVD	Sumitomo TEOS PECVD	住友精密 MPX-CVD	○		☆					○			○	
	D-07	SPPテクノロジー TEOS PECVD	SPP Technologies TEOS PECVD	SPPテクノロジー APX-Cetus	○		☆					○				
	D-08	JPEL PECVD	JPEL PECVD	日本生産技術研究所 VDS-5600					☆							
	D-09	W-CVD	W-CVD	Applied Materials P-5000							☆					
	D-10	芝浦スパッタ装置 (加熱型)	Shibaura sputtering (heating)	芝浦メカトロニクス CFS-4ESII	○	○	○	○	☆	○	☆		○	○		
	D-11	芝浦スパッタ装置 (冷却型)	Shibaura sputtering (cooling)	芝浦メカトロニクス CFS-4ESII	○	○	○	○	☆	○	☆		○	○		
	D-12	自動搬送 芝浦スパッタ装置	Automatic Shibaura sputtering	芝浦メカトロニクス I-Miller CFS-4EP-LL		○			☆		☆					
	D-14	ECRロングスロースパッタ	ECR long-throw sputtering	エリオニクス EIS-200ERP-NPD-TK						○		☆				
	D-15	アネルバマルチスパッタ	Anelva multi-sputtering	アネルバ SPC-350						☆		○				
	D-16	酸素加圧RTA付高温スパッタ装置	High-temp. sputtering and O2 annealing	ユーテック 21-0604		☆										
	D-17	アネルバスパッタ装置	Anelva sputtering	アネルバ SPF-730							○	☆			☆	
D-18	球面成膜用スパッタ装置	Sputtering for ball	和栄テック		☆											
D-19	電子ビーム蒸着装置	EB evaporation	アネルバ EVC-1501								○	☆				
D-20	めっき装置	Electroplating	山本鏡金試験器						☆							
D-21	多元材料原子層堆積(ALD)装置	ALD	テクノファイン ALK-600		☆											
D-22	ゾルゲル自動成膜装置	Automatic sol-gel deposition	テクノファイン PZ-604		☆											
D-23	MOCVD	MOCVD	ワコム研究所 Doctor T		☆											
D-24	シンクロン スパッタ装置	Shincron sputtering	シンクロン RAS-1100B II			☆										

担当者	mail address
戸津	kentaro.totsu.e4
森山	mimoriyama
渡邊	hiraku.watanabe.d5
菊田	toshiyuki.kikuta.c6
辺見	masahiro.hemmi.b5
庄子	masaaki.shoji.e4
吉田	tyoshida
松本	koji.matsumoto.b6
鶴谷	toshinori.tsuruya.c4
八重樫	koshiro.yaegashi.d1
吉林	yoko.furubayashi.e5
村上	akishige.murakami.c6

@tohoku.ac.jpを追加してください。

分類	番号	装置名称	Equipment name	メーカー/型番	☆：主担当 ○：オトシ対応可能												
					戸津	森山	渡邊	菊田	辺見	庄子	吉田	松本	鶴谷	八重樫	吉林	村上	
エッチング	E-01	DeepRIE装置 #1	DeepRIE #1	住友精密 MUC-21	○	☆	○		○	○						○	
	E-02	DeepRIE装置 #2	DeepRIE #2	住友精密 MUC-21	○	☆	○		○	○						○	
	E-03	DeepRIE装置 #3	DeepRIE #3	STS	○	☆											
	E-04	DeepRIE装置 #4	DeepRIE #4	住友精密 MUC-21		☆											
	E-05	アルバックICP-RIE #1	Ulvac ICP-RIE #1	アルバック NE-550		○	☆										
	E-06	アルバックICP-RIE #2	Ulvac ICP-RIE #2	アルバック CE-300I		○	☆										
	E-07	アルバック多用途RIE装置	Ulvac RIE	アルバック RIH-1515Z		☆					○						
	E-08	アネルバRIE装置	Anelva RIE	アネルバ DEA-506				○		☆	○						
	E-09	アネルバSi RIE装置	Anelva Si RIE	アネルバ L-507DL						☆	○						
	E-10	AI-RIE装置	AI-RIE	芝浦メカトロニクス HIRRIE-100							☆	○					
	E-11	プラズマクリーナー	Plasma cleaner	ヤマト科学 PDC210	○	○		☆	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	E-12	アルバック アッシング装置	Ulvac asher	アルバック UNA-2000				☆		☆							
	E-13	ブランソン アッシング装置	Branson Asher	ブランソン IPC4000		○		☆		☆	○						
	E-14	ケミカルドライエッチャー (CDE)	Chemical Dry Etcher (CDE)	芝浦メカトロニクス CDE7					☆								
	E-15	イオンミリング装置	Ion milling	エヌ・エス/伯東 201BE-C		○		☆									
	E-16	Vapor HFエッチング装置	Vapor HF etching	住友精密 Primaxx uEtch							○	☆					
	E-17	KOHエッチング槽	KOH etching					☆									
	E-18	TMAHエッチング槽	TMAH etching					☆									
接合・研磨・パッケージング	F-01	Suss ウェハ接合装置	Wafer bonder	Suss SB6e		○			☆						☆		
	F-02	EVG ウェハ接合用アライナ	EVG aligner for wafer bonding	EVG Smart View Aligner						☆					☆		
	F-03	EVG ウェハ接合装置	EVG wafer bonder	EVG 520						☆					☆		
	F-04	EVG プラズマ活性化装置	EVG plasma activation	EVG 810						☆					☆		
	F-05	ディスコ ダイス	Disco dicer	ディスコ DAD-522		○	☆										
	F-06	東京精密 ダイス	Accretech dicer	東京精密							☆						
	F-07	ワイヤボンダ	Wire bonder	West Bond							○				☆		
	F-08	レーザーマーカ	Laser marker	GSI ルモニクス WM-II		○					☆						
	F-09	サンドブラスト	Sand bluster	新東					☆								
	F-10	4インチウェハ研磨装置	4" wafer polisher	BNテックロジ Bni52					○								☆
	F-11	6インチウェハ研磨装置	6" wafer polisher	BNテックロジ Bni62					○								☆
	F-12	サーフェイスプレーナ	Surface planer	ディスコ DAS8920				☆									
	F-13	UVインプリント装置	UV imprint	東芝機械 ST-50						☆						☆	
	F-14	熱インプリント装置	Thermal imprint	オジシ電気 Reprina-T50A						☆						☆	
	F-15	エキシマ洗浄装置	Excimer lamp cleaner	デアネヒステ EXC-1201-DN						☆						☆	
	F-16	セミオートワイヤボンダ	Semi-automatic wire bonder	TPT HB16												☆	☆
	F-17	サブフェムト・インクジェット	Sub-femto inkjet	SIJテック PR150-THU													☆
	F-18	光造形3Dプリンター	Stereolithography 3D printer	シーフォース 028J plus													☆
F-19	マイクロマニピュレータ	Micromanipulator	マイクロサポート													☆	
F-20	ウォーターレーザ	Water laser	滋谷工業 LAMICS AQL-1900					☆									
測定	G-01	ウェハゴミ検査装置	Wafer dust counter	トプコン WM-3											☆		
	G-02	膜厚計	Film thickness measurement	ナメトリクス NanoSpec3000	○	○	○			☆		○	○				
	G-03	卓上型エリプソメータ	Desktop Ellipsometer	フォトニックラティス SE-101					☆								
	G-04	エリプソメータ	Ellipsometer	アルバック					☆								
	G-05	Dektak 段差計	Dektak surface profiler	Dektak 8		○	○	○	○	○	☆	○	○	○			
	G-06	Tencor 段差計	Tencor profiler	Tencor AlphaStep 500	○	○	○	○	○	○	☆	○	○	○			
	G-07	金属顕微鏡	Microscope	ニコン L150	○	○	○	○	○	○	☆	○	○	○	○	○	○
	G-08	デジタル顕微鏡	Digital microscope	キーエンス/クローテッククラフト	○	○	○	○	○	○	☆	○	○	○	○	○	○
	G-09	赤外線顕微鏡	Infrared microscope	オリンパス/浜松ホトニクス	○	○	○			○	☆						
	G-10	レーザー/白色共焦点顕微鏡	Laser/white light confocal microscope	レーザーテック OPTELCIS HYBRID LS-SD	○	☆				○		○	○	○	○		
	G-11	深さ測定装置	Depth measurement	ユニオン光学 Hisomet	○	○		☆	○	○	○	○	○	○	○		
	G-12	超音波顕微鏡	Ultrasonic microscope	インサイト IS-350	○										☆		
	G-13	マイクロX線CT	Micro X-ray CT	コムスキャンテック ScanXmate D160TS110	☆											○	
	G-14	熱電子SEM	SEM	日立 S3700N	○	○	☆					○	☆	○	○	○	
	G-15	断面SEM	Cross section FE-SEM	日立 S5000	○	○	☆						○			○	
	G-16	JEOL FE-SEM	JEOL FE-SEM	日本電子 JSM-6335F				☆							☆		○
	G-17	測長SEM	CDSEM	日立ハイテック CS4800											○	☆	
	G-18	クイックコート	Quick coater	サンヨー電子 SC-701MK11	○	○	○								☆		○
G-19	パーク・システムズAFM	Park systems AFM	パーク・システムズ NX20											☆		○	
G-20	4探針測定装置	4-terminal prober		○	○	☆	○	○	○	○							
G-21	拡がり抵抗測定装置	Spreading resistance measurement	Solid State Measurements SSM150											○		☆	
G-22	FIB	FIB	SII SMI9200				☆										
G-23	XRD	XRD	ブルカー・エイテックスエス D8 DISCOVER				☆										
G-24	直線集束ビーム超音波材料解析システム #1	Line-focus-beam acoustic microscope #1		○													
G-25	直線集束ビーム超音波材料解析システム #2	Line-focus-beam acoustic microscope #2		○													
G-26	Zygo Nexview	Zygo Nexview	Zygo Nexview	○											☆		
G-27	半導体パラメータアナライザ	Semiconductor parameter analyzer	Keysight B1500A SMU B1511B x4 GNDU	☆											○		
G-28	2光子励起顕微鏡	Two-photon excitation microscope	ライカ TCS SP8 MP STED													☆	

Tel. 022-229-4113

担当者	mail address
戸津	kentaro.totsu.e4
森山	moriyama
渡邊	hirako.watanabe.d5
菊田	toshiyuki.kikuta.c6
辺見	masahiro.hemmi.b5
庄子	masaaki.shoji.e4
吉田	tyoshida
松本	koji.matsumoto.b6
鶴谷	toshinori.tsuruya.c4
八重樫	koshiro.yaegashi.d1
吉林	yoko.furubayashi.e5
村上	akishige.murakami.c6

@tohoku.ac.jpを追加してください。